

PQFN

PQFN (功率四方扁平无引脚) 是专为各种高功率应用量身定制的高效空间节约封装。作为当今功率电子世界的“智能功率”选项，PQFN 比标准低功率切割 QFN 封装更进一步，而且也比其他分立式功率封装更为灵活 (集成电路控制晶片集成设计)。

- ▶ 该封装的特性
 - ▷ 非常低的寄生和电感效应，具有世界一流的导通阻抗
 - ▷ 出色的 EMI 表现和卓越的热性能
 - ▷ 从 3 x 3 mm 到 8 x 8 mm 的空间节约设计
 - ▷ 大量不同的多晶片、多夹片打线可供选择
 - ▷ 支持各种 GaN 应用/解决方案
 - ▷ 绿色材料：无铅电镀和无卤素模塑化合物

应用

PQFN 适用于中功率应用，且专为低导通电阻和高速切换式 MOSFET 而量身定制。

- ▶ 服务器
- ▶ 便携式电子设备
- ▶ 笔记本电脑
- ▶ 汽车
- ▶ 电信
- ▶ 轻型电动车 (LEV)
- ▶ 电池管理
- ▶ IoT

测试服务

Ankor 为全部功率器件产品提供完全一站式的服务。我们有能力测试各种类型的功率器件，包括 MOSFET、双极型晶体管、IGBT、二极管和稳压器 IC/智能化电源器件。

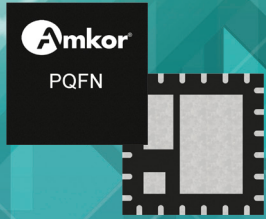
- ▶ Ankor 功率测试系统
 - ▷ ETS88
 - ▷ ETS364
 - ▷ ETS800
 - ▷ PowerTech (一般针对分立器件解决方案)
 - ▷ 测试能力示例
 - » 静态测试 (直流)
 - » 动态测试 (交流、开关/Trr、电容/Rg)
 - » 破坏测试 (电感负载/VsUS、I latch、电涌、绝缘/VIL)
 - » 热阻 (ΔVDS 、 ΔmV ，等等)
- ▶ 程序生成/转换
- ▶ 故障分析
- ▶ 全方位的加工技术
- ▶ 集成打标、外观检查和卷带式包装服务

工艺亮点

- ▶ 晶粒贴装：55 微米薄晶粒拾取功能
- ▶ 电镀：100% 雾锡
- ▶ 局部镀银的粗化铜引线框架
- ▶ 互连：热和电气性能更出色的铜片技术

全新开发

- ▶ 可润湿侧翼，适用于汽车市场
- ▶ 封装提供双外露式散热板选项
- ▶ 窄切割的薄晶圆切割



PQFN

标准材料

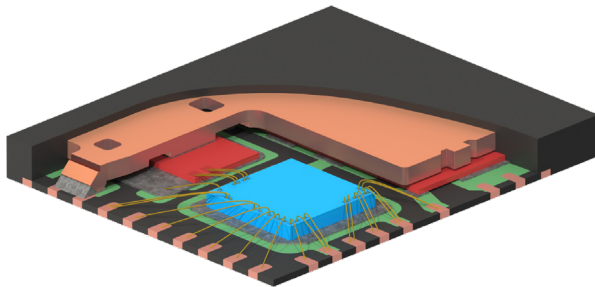
- ▶ 引线框架
 - ▷ 粗化铜
 - ▷ PPF (预电镀框架)
- ▶ 晶片贴装
 - ▷ 适用于功率 MOSFET 和 GaN 的焊膏
 - ▷ 适用于 IC 控制晶片的环氧树脂或晶片贴装薄膜
- ▶ 互连 (3 种选项)
 - ▷ 铜片
 - ▷ 多铜线
 - ▷ 多种金线
- ▶ 模塑化合物
 - ▷ 无卤素

装运

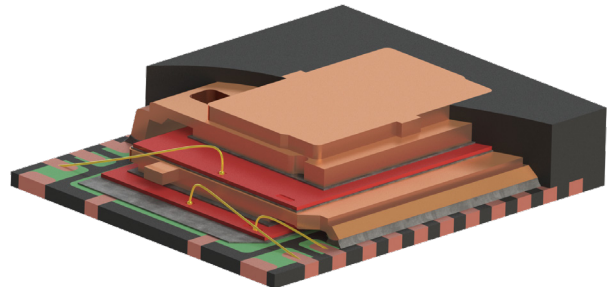
- ▶ 卷带式包装
- ▶ 料盘或料筒
- ▶ 条形码封装标签
- ▶ 直接代发货

横截面

PQFN 单堆叠



PQFN 双堆叠



访问 amkor.com 或发送电子邮件至 sales@amkor.com 以获得更多信息。

关于本文档中的信息，Amkor 对其准确性或使用此类信息不会侵犯第三方的知识产权不作任何担保或保证。Amkor 对因使用或依赖它而造成的任何性质的损失或损害概不负责，并且不以此方式默示任何专利或其他许可。本文档不以任何方式扩展或修改 Amkor 其任何产品的标准销售条款和条件中规定的保修。Amkor 保留随时对其产品和规格进行更改的权利，恕不另行通知。Amkor 名称和标志是 Amkor Technology, Inc. 的注册商标。所提到的所有其他商标是各自公司的财产。© 2019 Amkor Technology, Incorporated. 保留所有权利。DS416A-CN 修改日期：12/19

